

2027年3月期 第1四半期（2026年4月～6月） 東京エレクトロン 決算説明会

2026年7月30日

内容：

- 連結決算の概要 川本 弘 （常務執行役員・CFO ファイナンス本部 ディビジョンオフィサー）
- 事業環境および業績予想 河合 利樹 （代表取締役社長・CEO）



将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の事業計画、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、政治経済情勢、半導体市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権、感染症の影響など、さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、極端な為替レートの変動がない限りにおいては、利益への影響は軽微です。

2027年3月期 第1四半期 連結決算の概要

2026年7月30日

常務執行役員・CFO ファイナンス本部 ディビジョンオフィサー
川本 弘



改めまして、川本でございます。
私から、2027年3月期第1四半期、連結決算の概要をご説明いたします。

損益状況（四半期）

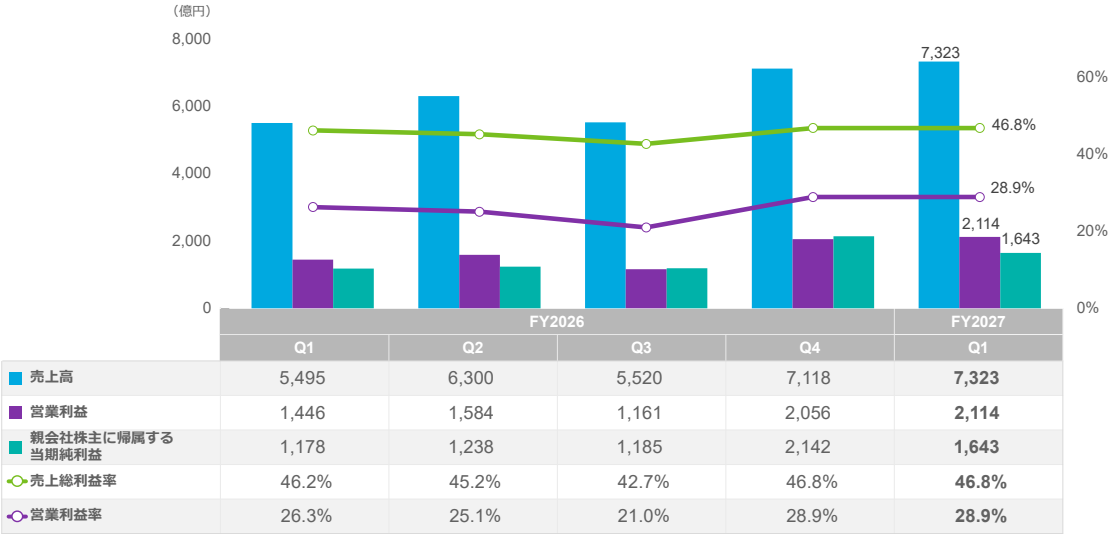
(億円)

	FY2026				FY2027	vs.	vs.
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	FY2026 Q4	FY2026 Q1
売上高	5,495	6,300	5,520	7,118	7,323	+2.9%	+33.3%
売上総利益	2,539	2,848	2,358	3,331	3,427	+2.9%	+34.9%
売上総利益率	46.2%	45.2%	42.7%	46.8%	46.8%	±0.0pts	+0.6pts
販管費	1,092	1,264	1,196	1,275	1,313	+2.9%	+20.2%
営業利益	1,446	1,584	1,161	2,056	2,114	+2.8%	+46.1%
営業利益率	26.3%	25.1%	21.0%	28.9%	28.9%	±0.0pts	+2.6pts
税金等調整前当期純利益	1,519	1,610	1,533	2,818	2,154	-23.5%	+41.8%
親会社株主に帰属する当期純利益	1,178	1,238	1,185	2,142	1,643	-23.3%	+39.5%
研究開発費	621	726	662	767	720	-6.2%	+15.9%
設備投資額	528	912	303	416	399	-4.1%	-24.4%
減価償却費	171	191	211	235	225	-4.4%	+31.2%

1. 当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、極端な為替レートの変動がない限りにおいては、利益への影響は軽微です。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。
3. FY2026は2025年4月～2026年3月の会計年度を指しています。FY2027は2026年4月～2027年3月の会計年度を指しています。

まず、四半期の「損益状況」についてご説明いたします。
青枠の部分を中心にご覧ください。
第1四半期の売上高は、顧客の積極的な投資姿勢を反映して前四半期比2.9%増加し、7,323億円となりました。
これにより、売上総利益は、前四半期比2.9%増加の3,427億円と、売上高とともに過去最高となりました。
売上総利益率は、前四半期と同等の46.8%でした。
営業利益は前四半期比2.8%増加の2,114億円。
営業利益率は、前四半期と同等の28.9%となりました。
また、親会社株主に帰属する当期純利益は、前四半期比23.3%減少の1,643億円となりました。
これは、前四半期に政策保有株式の売却による特別利益が含まれていたことによるものです。

損益状況（四半期）



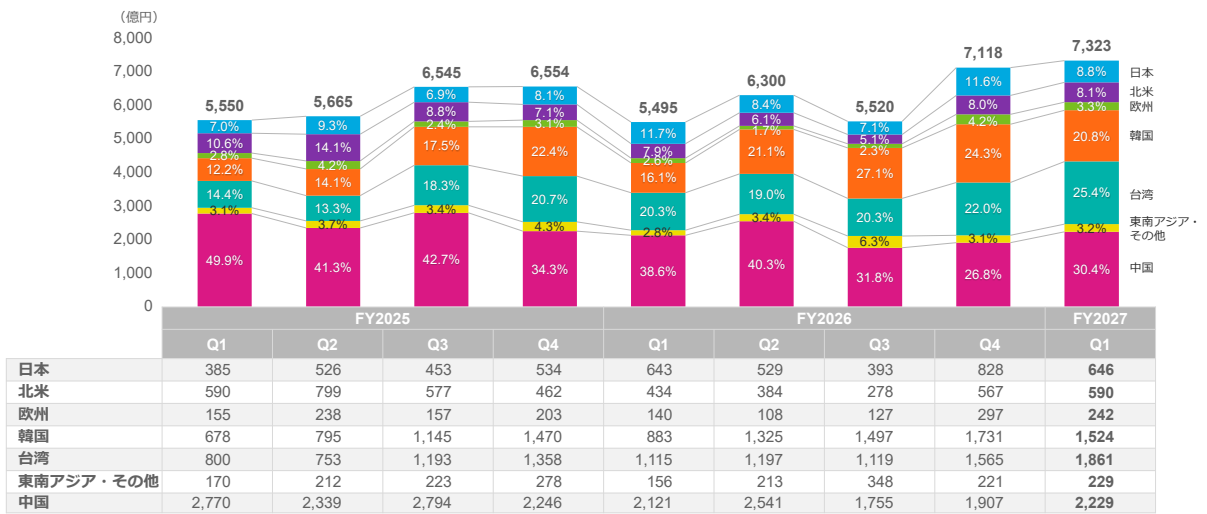
Investor Relations / July 30, 2026

TEL

5

こちらのグラフは、先ほどご説明させていただいた業績を時系列で示しておりますので、ご確認ください。

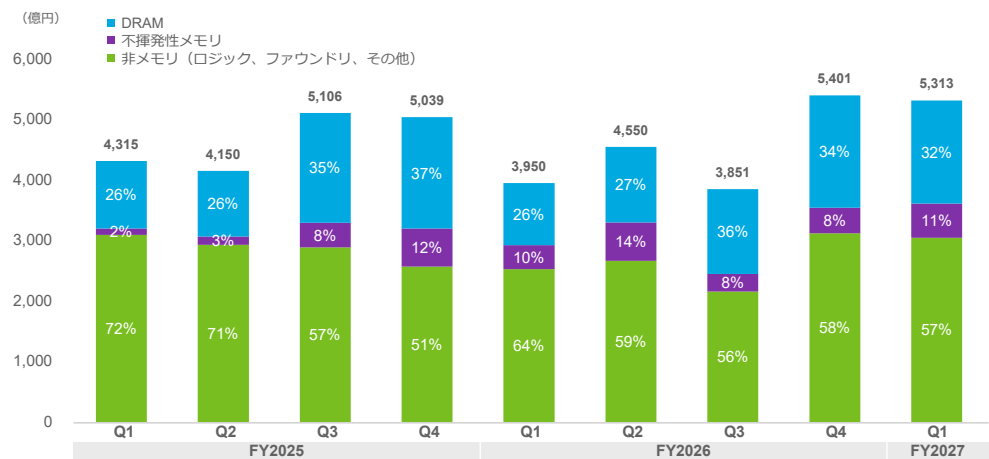
地域別売上高構成比（四半期）



FY2025は2024年4月～2025年3月の会計年度を指しています

こちらは、「地域別売上高」です。
台湾向け売上高は、前四半期比18.9%増加し、構成比は25.4%となりました。
また、中国向けの売上高構成比は、前四半期比3.6ポイント増加の30.4%となりました。
なお、2027年3月期 通期では、中国向け比率は30%台前半になることを想定しております。

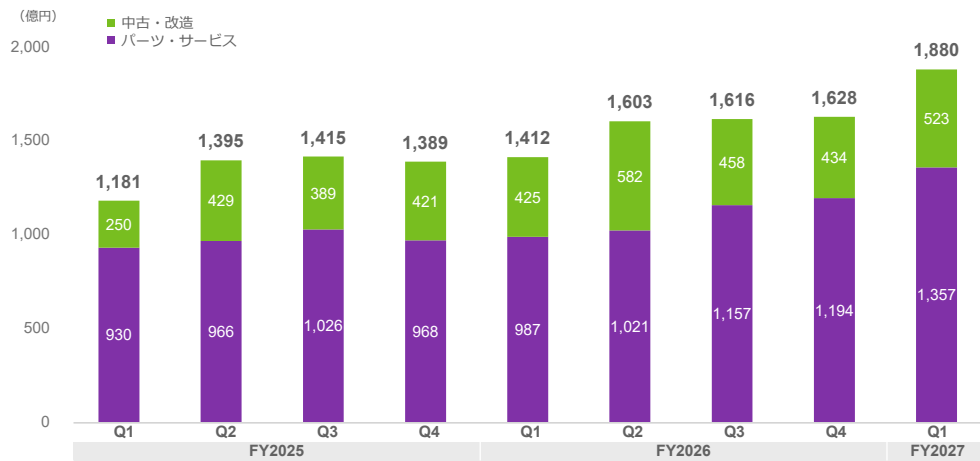
SPE新規装置 アプリケーション別売上構成比（四半期）



1. SPE (Semiconductor Production Equipment) : 半導体製造装置
 2. グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューションの売上高は含まれていません。

こちらは、「SPE新規装置のアプリケーション別 売上構成比」です。
 第1四半期の構成比は、上からDRAM 32%、不揮発性メモリが 11%、非メモリが 57%となりました。
 SPE新規装置の売上高は 前四半期に続き堅調に推移しました。
 特に、不揮発性メモリは向けは前四半期比32%増加いたしました。

フィールドソリューション売上高（四半期）

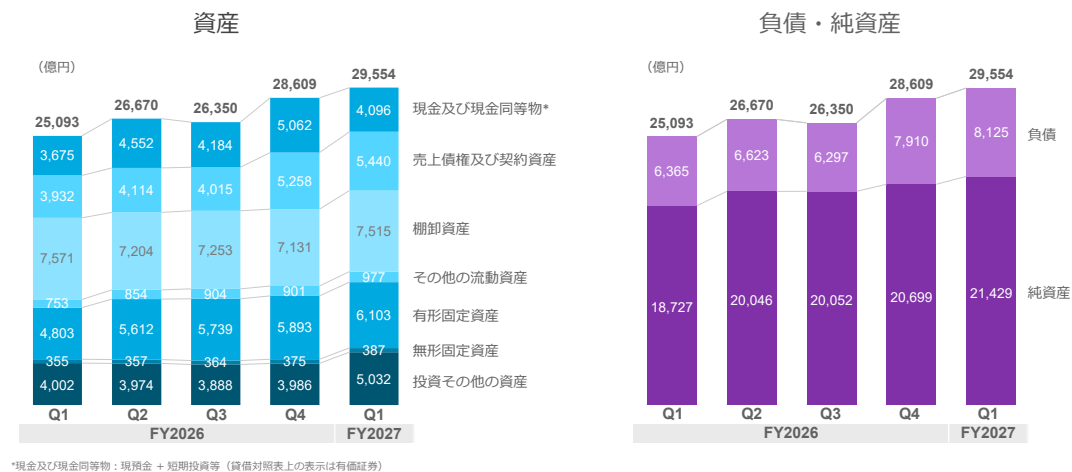


こちらは、「フィールドソリューションの売上高」です。

第1四半期は、前四半期から15.5%増加し、1,880億円となりました。

顧客の工場稼働率が引き続き高く、パーツ・サービスが 前四半期比13.7%増加と成長しているほか、生産性向上のための改造案件を含めた 中古・改造は前四半期比で20.5%増加と特に高い成長率を示しました。

貸借対照表（四半期）



続きまして、「貸借対照表」をご説明いたします。

資産合計は、2兆9,554億円となりました。

現金同等物は、4,096億円。

前四半期から966億円減少いたしました。

主に、株主さまへの配当金の支払いや納税等によるものです。

売上債権及び契約資産は、前四半期比181億円増加の5,440億円。

棚卸資産は、前四半期比384億円増加の7,515億円。

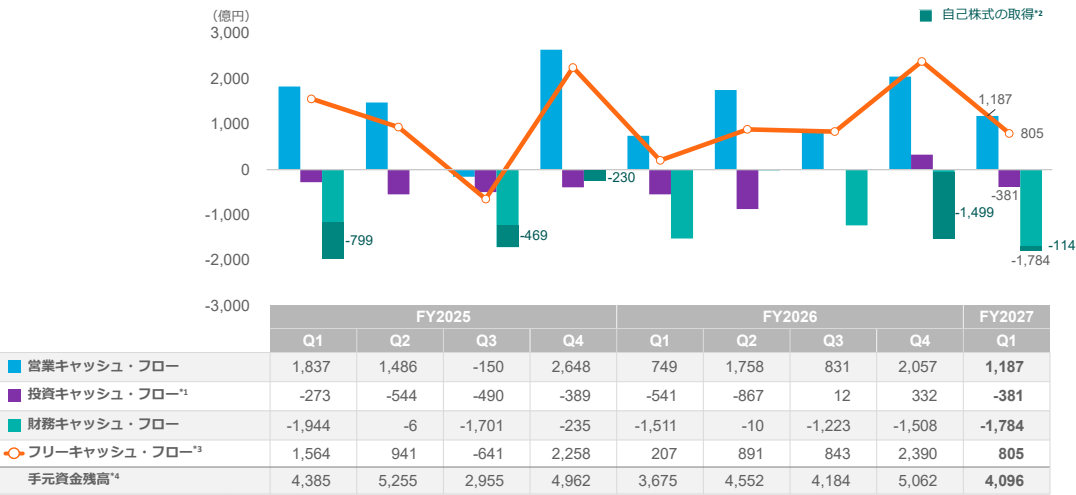
在庫は増加しておりますが、回転日数は改善しました。

有形固定資産は、前四半期から210億円増加し、6,103億円となりました。

続いて、右側の負債・純資産でございますが、負債は、前四半期から215億円増加の8,125億円となりました。

純資産は、前四半期比729億円増加の2兆1,429億円となりました。

キャッシュ・フロー（四半期）



^{*1} 投資キャッシュ・フローは、定期預金および短期投資の増減を除いた金額です。
^{*2} 自己株式の取得は、単元未満株式の買取りに要した金額を除いた金額です。
^{*3} フリーキャッシュ・フロー＝営業キャッシュ・フロー＋投資キャッシュ・フロー（定期預金および短期投資の増減を除く）
^{*4} 手元資金は、現金及び現金同等物と満期日または償還日までの期間が3カ月を超える定期預金および短期投資の合計額です。

続きまして、「キャッシュ・フロー」をご説明いたします。
この四半期における営業キャッシュフロー獲得は、1,187億円でした。
投資キャッシュフローは、381億円の支出となりました。
財務キャッシュフローの支出は、主に配当金の支払いにより、1,784億円。
また、フリーキャッシュフローは、805億円の収入となりました。
私からのご説明は以上です。ありがとうございました。

事業環境および業績予想

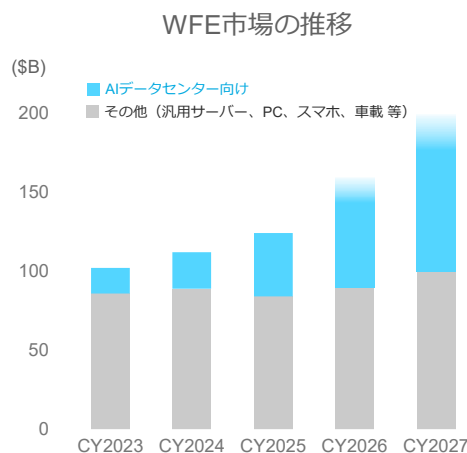
2026年7月30日

代表取締役社長・CEO
河合 利樹



皆さま、改めまして、河合でございます。
わたくしの方から、「事業環境 および 業績予想」について、ご説明致します。

事業環境（2026年7月時点でのWFE市場の見方）



WFE市場の見通し

- CY2026：\$150B以上
- CY2027：\$190B以上
- GPU・HBMに加え、汎用メモリ・CPUの需要が拡大
- 先端デバイス向けの投資計画が加速

AIデータセンター向けが、WFE全体の50%に達する勢いで成長
先端領域に注力する当社の事業機会は一層拡大

Investor Relations / July 30, 2026

TEL

12

まず、「事業環境」について、ご説明します。

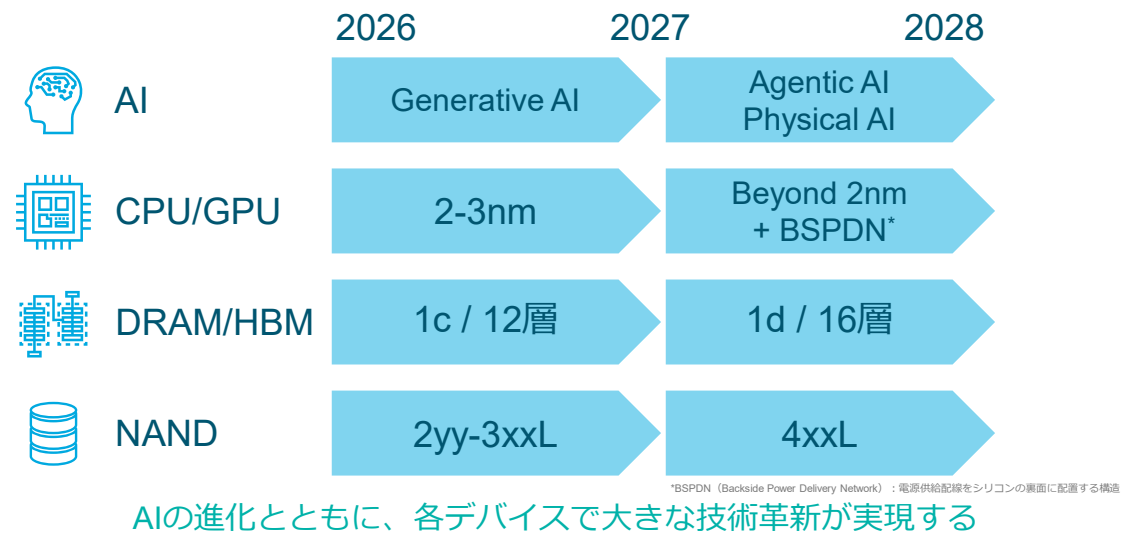
WFE市場については、今年、CY2026は150Bドル以上、来年CY2027は190Bドル以上と、4月末の予想から、見通しを更新いたしました。

両年とも、前年比 20%以上の成長を見込んでおります。

グラフでお示ししている通り、AIデータセンター向け投資が、WFE市場をけん引しており、AI元年と言われている CY2023からCY2027の5年間で、5倍以上の市場規模に成長する予測です。

AIデータセンターは、GPU、HBMのみならず、DDR、CPU、3D NAND等、幅広いデバイスが必要であり、先端デバイス向けの投資計画が加速しています。

AIの進化と半導体の技術トレンド



こちらは、「AIの進化と半導体の技術トレンド」です。

現在の生成AIから、エージェントAI・フィジカルAIの実装が本格的に進んでいきます。

CPU・GPUでは、現在主流の3nmからさらに微細化が進むとともに、電力を効率的に供給できる、Back Side PDNが採用されます。

DRAMは1cから1d世代へ進み、HBMの積層数も12層から16層に。

NANDは、いよいよ、300層、さらには400層へ移行が進みます。

これらの大きな技術革新が、わずか2年ほどの間に、実現されます。

また、従来ボトルネックと言われたファブスペースの拡充に向け、最先端半導体を生産する大型ファブ建設が、目下、多数、進行しています。

中期経営計画 財務目標達成に向けた進捗

財務目標（～2027年3月）		
売上高	≥ 3兆円	On Track
営業利益率	≥ 35%	In Progress
ROE	≥ 30%	On Track

営業利益率の目標達成はチャレンジングだが、
これまでの着実な進捗により、1兆円の営業利益が視野に

そのような中、こちらは2022年に策定した当社の中期経営計画でございます。
改めて、ご説明いたしますと、売上高で3兆円以上、営業利益率で35%以上、ROEで30%以上の実現を本年度をターゲットイヤーとして、活動しております。
売上高については、上期の見通しが1.6兆円を超え、下期も更に強い引き合いを頂いており、3兆円以上の達成が見えてきております。
ROEに関しましても、純利益の増加と、資本効率の向上により、30%以上の達成が見込める状況です。
一方で、当社を取り巻く事業環境は、以前に増して、大きく変化しています。
米中対立に伴う規制や関税、中東紛争や、ロシア・ウクライナ戦争の長期化などの地政学的な影響、それに伴う世界的なインフレや為替変動、顧客の投資計画の変更など、中期経営計画設定時点では想定していなかった事象も顕在化しています。
こうした様々な事業環境の変化により、営業利益率については、目標達成にはチャレンジングな状況ではありますが、これまでの着実な進捗により、1兆円の営業利益が視野に入ってきました。

収益性改善に向けた取り組み

1. 付加価値の高い次世代装置の創出
2. 生産性向上に寄与するアップグレード
3. AIやロボティクスを利用したサービスの展開 + Epsira
4. スタートアップの効率化・短縮
5. 価格設定の適正化

稼ぐ力を究明・追求し、市場の変化に適切に対応する

中期経営計画で掲げた目標を達成し、更なる高みを目指すためには、稼ぐ力を究明・追求し、市場の変化に適切に対応することが重要です。

高付加価値の新モデル・アップグレードをタイムリーに提供するのはもちろんのこと、AIやロボティクスを用いてサービスを強化し、顧客の歩留まり改善や装置稼働率の向上に貢献していきます。

昨年12月に発表したEpsira™は、フィールド生産性向上を目指す当社のデジタル基盤です。

今月、NVIDIA社との協業拡大を発表した通り、エージェント型AI、および、ロボティクスに関するソリューション開発を推進していきます。

また、多数の大規模ファブ建設が計画される中、リソースのひっ迫に対処するために、スタートアップの効率化や短縮も重要な施策となります。

自動化も含めたより迅速な立上げに向けて、設計段階から創意工夫を施してまいります。

加えて、昨今のインフレーションに伴うコスト増については、価格設定を適正化し、対処してまいります。

これらの取り組みを通じて、大きな利益率の改善に努めてまいります。まずは足元、2年以内に売上総利益率50%超を目指してまいります。

2027年3月期の事業進捗と今後の事業機会

事業進捗 (FY2027売上成長ドライバー)

塗布現像	売上成長率 50%+ YoY	■ 新製品CLEAN TRACK™ LITHIUS Pro DICE™ 順調に展開中 ■ 先端ロジック・DRAMの複数工程でPOR^{*1}
エッチング	売上成長率 25%+ YoY	■ 先端ロジック/メモリの投資加速で通期売上1兆円が視野に ■ DRAM向けHARCエッチングで新モデルでの評価が順調に進捗
Advanced Packaging	売上成長率 70%+ YoY	■ 特にプローバは、ハイエンドロジックで圧倒的なポジション。通期1,000億円を大きく超える見通し。新モデルの評価も順調

^{*1} POR (Process of Record) : 顧客の半導体製造プロセスにおける装置採用の認定

今後の事業機会 (ハイライト)

POR→ 量産展開へ	■ 極低温エッチング ■ 新低抵抗メタル成膜 ■ ハイブリッドボンディング
累積売上 ~2030年	■ DRAM配線工程エッチング装置 : 1兆円 ■ ボンディング関連装置 : 5,000億円
新規参入 SAM拡大	■ 埋め込み膜用 枚葉プラズマCVD : PECVD市場の約10% ■ デバイスプローバ : プローバ市場の約10~15% Prexa™ SDP^{*2}をリリース

^{*2} SDP : Singulated Device Prober

さて、ご説明した取り組みを進める中で、ご覧のような進捗と事業機会があります。まず、「当期 FY2027の事業進捗」です。前回の決算説明会でご説明した通り、塗布現像・エッチング・アドバンストパッケージングは、当期の売上成長ドライバーとなっております。塗布現像装置においては、新製品CLEAN TRACK™ LITHIUS Pro DICE™が順調に顧客に展開されており、先端ロジック・DRAMの複数工程でのPORを獲得しております。そして、エッチング装置は通期の売上で1兆円が視野に入ってきました。最先端DRAM向けHARCエッチングでは、新モデルのPOR認定に向け、評価が順調に進んでいます。また、アドバンストパッケージングにおいては、プローバの売上成長が目覚ましく、通期1,000億円を大きく超える見通しです。吸熱技術を更に高めた新モデルの評価も順調に進んでおります。次に、今後の「事業機会」に触れさせていただきます。こちらは、以前の決算説明会でご説明したものも含めたハイライトとなっております。エッチング装置では、NAND 400層向けの極低温エッチング装置の量産展開CY2027からいよいよ始まります。新低抵抗メタル成膜装置のPORも獲得し、新たな領域での売上貢献が期待できます。ボンダー・レーザー関連装置においては、最先端の前工程技術とボンディング技術を単独で併せ持つ企業として、各デバイスのクリティカルなボンディング工程の課題解決に貢献してまいります。当社が得意とする、DRAM配線工程向けエッチング装置は、DRAM向け投資の急速な拡大にともない、2030年までの5年間の累積売上が、当初予定の5,000億円を大きく超え、1兆円も射程圏内に入ってきました。また、先端ロジック向け デバイスプローバ Prexa™ SDPを4月にリリースいたしました。高度化するテスト工程において、顧客の高い期待に応えてまいります。

2027年3月期上期 業績予想

	FY2026 (実績)			FY2027 (新予想)	(億円)
	H1	H2	通期	H1	
売上高	11,796	12,638	24,435	16,200	15,700
売上総利益	5,388	5,690	11,078	7,480	7,150
売上総利益率	45.7%	45.0%	45.3%	46.2%	45.5%
販管費	2,357	2,472	4,829	2,900	2,840
研究開発費	1,348	1,430	2,778	1,600	1,600
研究開発費以外の販管費	1,008	1,041	2,050	1,300	1,240
営業利益	3,031	3,217	6,249	4,580	4,310
営業利益率	25.7%	25.5%	25.6%	28.3%	27.5%
税金等調整前 当期純利益	3,129	4,351	7,481	4,640	4,370
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,416	3,328	5,744	3,490	3,280
1株当たり当期純利益（円）	527.31		1,254.57	767.51	721.12

- FY2027 上期：
活況な先端投資を背景に、
売上高を1兆6,200億円へ上方修正
- FY2027下期：
需要拡大の勢いは一段と加速。
上期を大きく上回る成長を想定
 - － 中東情勢の影響、サプライチェーンの動向
は要注視

次に、「業績予想」についてご説明します。

旺盛なAIサーバー向け需要を背景に、足元では、顧客からの納期前倒しや追加購入の要請が続いています。

第1四半期の実績と最新の市場動向を反映し、今上期の業績予想を上方修正いたします。

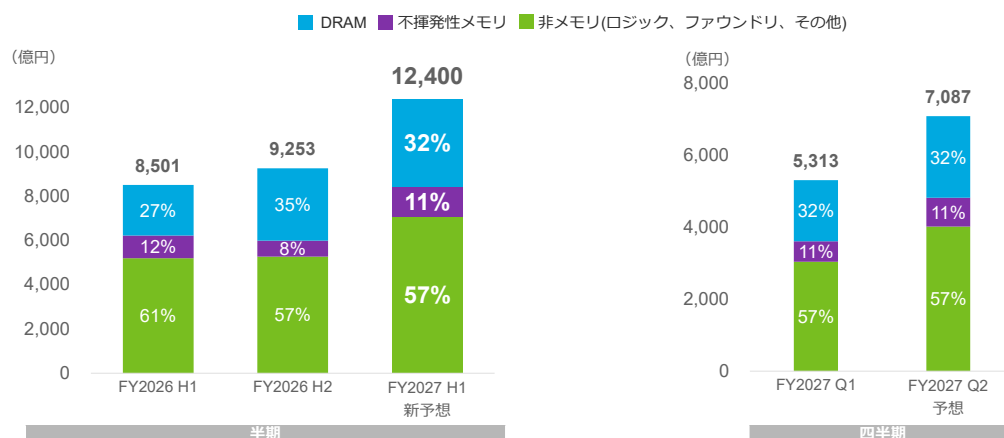
売上高 1兆 6,200億円、売上総利益 7,480億円、営業利益 4,580億円 と、いずれも、半期で 過去最高の業績を見込んでおります。

また、FY2027 下期につきましては、需要拡大の勢いが一段と加速する見通しです。メモリや先端ロジック向けを中心に、更に出荷が増加し、上期を上回る力強い成長を想定しています。

なお、中東情勢など、地政学の影響やサプライチェーンの動向に関して、現時点においては、特筆すべき支障はございませんが、引き続き注視し、適切に対応してまいります。

2027年3月期上期 SPE新規装置売上予想

アプリケーション別売上構成比



* グラフは新規装置の売上における構成比を示しています。フィールドソリューション売上高は含まれていません。

上期の新規装置売上を1兆2,400億円に上方修正
Q2は四半期最高の7,087億円（前四半期比 +33%）を見込む

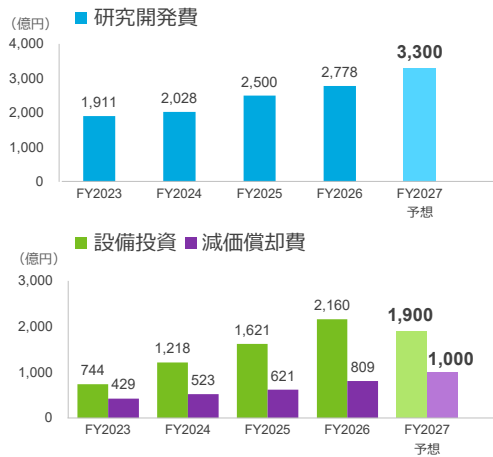
Investor Relations / July 30, 2026

TEL

18

こちらは、「2027年3月期の SPE新規装置の売上予想」です。
今上期の新規装置の売上は、前年同期比 45%増の 1兆2,400億円 となる見込みです。
アプリケーションごとの内訳は、ご覧の通りです。
AIサーバー需要にけん引され、先端デバイス向けの装置売上が伸長する計画です。
また、第2四半期の新規装置売上は、四半期として過去最高の、7,000億円を超える水準に到達する見込みです。

2027年3月期 研究開発費・設備投資計画



宮城県黒川郡
2027年夏竣工予定

スマートプロダクション構想の目標

労働生産性

4倍

スペース効率

3倍

生産リードタイム

1/3

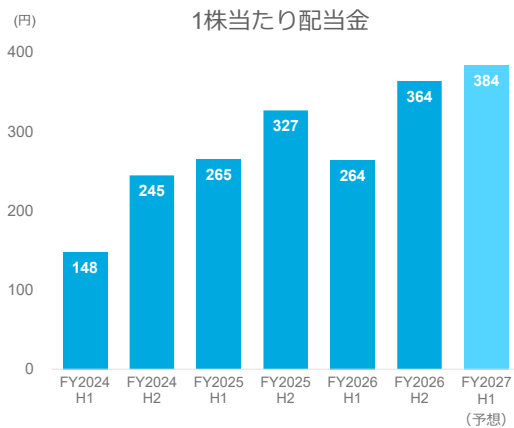
生産キャパシティ

3倍

研究開発投資を主軸に競争力の強化を継続
強固なインフラを活用し、今後の収益機会を着実に捉える

次に、「研究開発費と 設備投資の 計画」についてです。
こちらは変更ございません。
FY2027の 研究開発費は通期 3,300億円を計画しており、技術競争力の源泉となる研究開発を積極的に推進し、半導体の技術革新を支えてまいります。
設備投資は、通期 1,900億円を予定しております。
前期に完成した開発棟における機械装置の取得や、来年夏にスマートファブとして竣工を予定しております宮城の生産新棟が主な内容です。
ここに記載しているような 強固なインフラを活用し、今後の収益機会を着実に捉え、企業価値の最大化に取り組んでまいります。

配当予想



当社の株主還元策

連結配当性向：50%

但し、1株当たり年間配当金50円を下回らない
2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得：機動的に実施を検討

FY2027 H1（中間配当）の1株当たり配当金は384円に上方修正

次に、「配当予想」についてです。
今上期の業績予想修正に基づき、FY2027の中間配当は、1株当たり384円を予定しており、こちらも過去最高となる見込みです。

自己株式の取得

最大1,500億円の自己株式取得を実行中

- 2026年5月29日開催の取締役会での決議内容
 - 取得対象株式の種類 : 当社普通株式
 - 取得し得る株式の総数 : 750万株（上限）*
(自己株式を除く発行済株式総数に対する割合 1.6%)
 - 株式の取得価額の総額 : 1,500億円（上限）*
 - 取得する期間 : 2026年6月1日～2027年3月31日

* 市場環境等により、全部の取得がおこなわれない可能性があります。

- 2026年6月30日現在の取得状況
 - 取得した株式の総数 : 207,100 株
 - 株式の取得価額の総額 : 11,474,246,000 円

拡大する当社の事業機会とキャッシュ創出力、資本効率の向上を考慮し、
今後も適切なバランスシート・マネジメントを実施

また、「自己株式の取得」に関しましては、5月29日の取締役会において決定されました、1,500億円を上限としたプログラムがご覧のスライドの通り、進捗しております。

今後も、適切なバランスシート・マネジメントをおこなってまいります。

株式分割

■ 目的	投資単位当たりの金額を引き下げることにより、より投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大を図る
■ 分割の方法	2026年9月30日を基準日として、同日付の株主の所有する当社普通株式を1株につき5株の割合をもって分割
■ 日程	基準日公告日 2026年9月15日(火) 基準日 2026年9月30日(水) 効力発生日 2026年10月1日(木)
■ 配当	2026年9月30日を基準日とする2027年3月期の中間配当は、株式分割前の株式数を基準に実施

また、自己株式の取得と同時にリリースさせていただきました、「株式分割」につきましては、2026年9月30日を基準日として、当社 普通株式を、1株につき 5株の割合をもって分割いたします。

投資単位当たりの金額を引き下げることにより、より投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大を図ります。

新体制のご紹介

■ コーポレートオフィサー

河合 利樹^{*1}
CEO（最高経営責任者）

林 伸一^{*1 *2}
開発生産担当

多田 新吾^{*2}
顧客戦略担当、Global Customer Engineering担当

堂 和寛^{*2}
コーポレート戦略企画担当

石田 博之^{*1}
COO（最高執行責任者）

秋山 啓一
製品事業担当

阿曽 達也^{*2}
Global Business Platform担当

^{*1} 取締役を兼務
^{*2} 新任

■ 新体制におけるCxO（抜粋）



CEO 河合 利樹



COO 石田 博之



CFO 川本 弘

最後に、本年7月1日からの「新体制について、ご紹介」いたします。
東京エレクトロンのサステナブルな成長と企業価値の向上に向けて、成長戦略を確実に推進する体制を構築しました。

こちらの7名のコーポレートオフィサーが、執行のトップとして、スピーディーに経営を進めてまいります。

また、COOを新設することで、戦略と実行の両輪をそれぞれ強化しました。

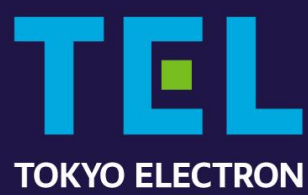
CEOは、中期経営計画 及び その先を見据えた成長戦略の策定・企業価値向上に責任を持ち、COOは、その戦略に基づく事業運営・業務執行を統括し、確実な実行に責任を持ちます。

加えて、ファイナンス（CFO）をはじめ、機能別・事業領域における執行責任者を明確化し、経営執行のスピードと実効性を高めてまいります。

今後とも、温かいご支援をお願い申し上げます。

私からのご説明は以上です。

ご清聴ありがとうございました。



本資料の取扱上の注意

当社の書面による承諾なしに複写、または
第三者への開示はできません。

東京エレクトロン

 および“TEL”は、東京エレクトロン株式会社の商標です。